

八重樫 浩樹

あらゆる"モノ"がインターネットにつながるInternet of Things(IoT)の時代を迎えて、膨大なデータの流れを収容 するためのネットワークの構築が急務となっている。IoT を支えるアクセスネットワークとして期待されるのが、現 在規格策定が進められている第5世代モバイルネット ワーク(5Gモバイル)である。モバイルネットワークで基 地局とコアネットワークを結ぶバックホールに使用される 光回線は、要求される通信容量も今後ますます増大の一 途をたどると予想される。また、5Gモバイル基地局と多 数のスモールセルアンテナとを結ぶフロントホールには、 既存の光アクセスファイバー網に収容する低コストなネット ワーク構成が検討されている。そのためには光インター フェースを小さなアンテナ装置に組み込むことが求めら れ、光トランシーバーの小型化が必須となる。

シリコンフォトニクスは光回路を超小型に低コストで製造できる技術である。光アクセスネットワーク向けの光トランシーバーにこれを適用することで、送信光源、受光素子、波長合分波フィルタ等の光トランシーバーを構成する 光学デバイスはシリコンのワンチップ上に集積され、桁違いの小型化とそれに伴う省電力化、組み立て工程の大幅な簡略化によるコスト低減が期待できる。

OKIは、技術研究組合光電子融合基盤技術研究所 (PETRA)の組合員企業として、国立研究開発法人新エ ネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO) より委託を受 けるプロジェクト「超低消費電力型光エレクトロニクス実 装システム技術開発」(光エレ実装Pj)に参画して、シリコ ンフォトニクス技術を用いたIoTネットワーク向け超小型 光トランシーバーの開発を進めている。本稿でその概要 について紹介する。

光エレ実装Pjの概要

光エレ実装Pjは、経済産業省の未来開拓研究プロジェ クトの一つとして平成24年9月に開始して、平成25年度か らはNEDO委託により実施されているプロジェクトである。 情報通信機器の省電力化と高速化を目的とし、電子機器 の電気配線を光化する光配線技術と電子回路技術を融 合させた、光エレクトロニクス実装システム技術を実現す る基盤技術を確立することを目指している。光電子集積 技術を軸に、データセンター等におけるサーバシステム、 光通信システム向けIT機器の省電力化技術の開発を推進 している。

IoTを支える5Gモバイルネットワーク

図1にIoTを支えるネットワーク構成の概要を示す。膨 大な数のセンサや端末装置につながるIoTネットワークの 末端を担うことを期待されるのが、5Gモバイルである。



図1 IoTを支える 5G モバイルネットワーク

5Gモバイル規格では、端末通信速度は最大10Gbpsに高 速化され、細分化したアンテナエリア(スモールセル)を 従来の100倍程度に高密度に配置して1km²当たり約100 万台の多数端末接続を想定している。

多数のスモールセルアンテナを結ぶフロントホールネットワークには様々な方式が検討されているが、中でも パッシブ光ネットワーク (PON)の構成を用いてスモール セルアンテナを既存の光アクセスファイバー網に収容する 方式が設備コストの観点から有望である。

PONは、局と加入者を結ぶ光ファイバーを分岐して、時間 多重により局と加入者を1対多で結ぶネットワーク構成で ある。局側設備と光ファイバー線路を複数の加入者で共用 するので、ネットワークの設備コストを低く抑えることが できる。局側と加入者側の光終端装置をそれぞれ光加入 者線終端装置(OLT)、光加入者線ネットワーク装置 (ONU)と呼ぶ。PONを用いるフロントホール構成では各 スモールセルアンテナにONUを組み込む。

5Gモバイルの通信容量を収容するためには、PONにさ らに波長多重を組み合わせた、Time and Wavelength Division Multiplexing-PON (TWDM-PON)を用いる。 TWDM-PONは、ITU-T G.989シリーズで規格が定めら れ、その構成概略は 図2に示す通りである。上り(加入者 →局)波長帯1524~1544nm、下り(局→加入者)波長帯 1596~1603nmを用いたシングルモード光ファイバー上の 一心双方向通信であり、上り下り各4波長を多重して、1波 長あたり10 Gbps、トータル40 Gbpsで通信する。



図2 TWDM-PON の構成

シリコンフォトニクスを用いた 超小型光トランシーバー

従来のONUは卓上サイズの装置であり、このままでは 5Gモバイルのスモールセルアンテナ装置には収まらな い。これを小型化してスモールセルアンテナに収めるた めには光トランシーバーの小型化が必須の課題であり、 SFP+¹¹サイズ(消費電力1.5W以下)のTWDM-PON ONU 用超小型光トランシーバーの実現がこの開発の目標で ある。 ONU用光トランシーバーは一心双方向光送受信モジュールとその駆動回路とからなる。一心双方向光送受信モジュールは、従来は送信光源、受光器、波長合分波フィルタ等の個別部品を組み立てて構成されていた。

我々はこれまでにシリコンフォトニクスを用いた超小型 光トランシーバーを開発してきた²⁾。現在開発中の TWDM-PON ONU用一心双方向光送受信チップ(以下、 光送受信チップと呼ぶ)の構成を 図 3に示す。



図 3 TWDM-PON ONU 用光送受信チップの構成

光送受信チップに必要な機能は、送信4波長の内の1 波長を選んで送信する機能、及び4波長多重されたラン ダム偏波の入力光の内の1波長を選んで受信する機能で ある。

送信光は、送信光源 (LD) アレイ、上り波長合波フィルタ (WDM2)、光変調器 (Mod)、上り下り波長合分波フィ ルタ (WDM1)、スポットサイズ変換器 (SSC) を経て光 ファイバーへ出力される。SSCはシリコン細線光導波路を伝 播する光ビーム径を出射端で拡大して光ファイバー中の光 ビーム径に近づけることにより、光結合損失を低減する。

一方、受信光の経路は、偏波依存性を解消するために 偏波ダイバーシティー構成とした。光ファイバーからSSC、 WDM1を経て、偏波スプリッタ(PBS)で、TE、TM偏波成 分に分離され、TE偏波成分はそのまま、TM偏波成分は偏 波回転素子(PR)でTE偏波に変換されて、それぞれアレイ 導波路型グレーティング(AWG)で波長分離された後、 受光器(PD)アレイで受光される。

各構成要素はシリコン細線光導波路で接続されている。 LDアレイは4波長のマルチストライプ半導体レーザチッ プで、1波長を選んで連続発振させる。LDアレイはフリッ プチップ実装されるが、それ以外の構成要素はすべてシ リコンチップ上にモノリシック集積されているので、組立 てコストが大幅に低減される。チップサイズはSFP+サイズ の超小型光トランシーバーへ搭載可能な5mm×3.5mm である。これにより、スモールセルアンテナに組み込める 小型ONUが低コストで実現できる。 次節では、光送受信チップを構成するシリコンフォトニ クス要素デバイスの内、波長合分波フィルタとゲルマニウ ム受光器について紹介する。

シリコンフォトニクス要素デバイス技術

(1) 波長合分波フィルタ

図4(a)は、上り下り波長合分波フィルタ(図3の"WDM1") の構成要素である偏波無依存バンドパスフィルタの構造 概略である³¹。偏波回転グレーティングと偏波無依存3dB カプラを組み合わせることにより、偏波無依存動作を実 現している。偏波回転グレーティングは光導波路のシリ コンコアの側面に左右反対称の凹凸(反対称グレーティ ング)を形成することにより、特定の波長の光を選択的に 反射し、なおかつ入射光のTE偏波成分を反射光のTE偏波成分 に変換する機能を持つ。



図 4(b)は、試作したバンドパスフィルタの反射スペクト ルである。TE、TMどちらの偏波の入射光に対しても反射 波長帯が完全に一致しており、両偏波に対する反射率の 差が0.2dB以下の優れた偏波無依存バンドパスフィルタ 特性を得た。

次に、波長多重された受信光を波長分離するAWG(図3 の"AWG")について紹介する。図5(a)は、試作したAWGの 光学顕微鏡写真である⁴⁾。約1.4mm角の素子サイズで、光 周波数間隔100GHz、8波長までの分離を行う。AWG自体は 偏波依存性が顕著であり、TE偏波のみを想定した設計なの で、光送受信チップでは、図3で示したように偏波ダイバー シティー構成と組み合わせて用いる。図5(b)に試作した AWGのフィルタスペクトル特性を示す。独自の素子形状設 計により、1.2dBの低損失と、-16dBの低い波長間クロス トークを実現して、TWDM-PONへ適用できるめどをつけた。



(2) ゲルマニウム受光器

ゲルマニウム (Ge) 受光器が光導波路にモノリシックに 集積できることは、シリコンフォトニクス技術を用いる大 きな利点の一つである。

図 6は、光送受信チップに用いている導波路型のGe受 光器(図 3の"PDアレイ"を構成)の断面構造模式図であ る⁵¹。シリコン(Si)光導波層上にGe光吸収層を結晶成長 により形成した。Si層をp型、Ge層上部をn型とするPIN フォトダイオードである。

試作したGe受光器は、逆バイアス1V時の暗電流が11nA と非常に低い、良好な電圧-電流特性を示した。図7(a) に、逆バイアス1V時の受光効率スペクトルを示す。100nm の波長範囲にわたって0.8A/Wのほぼフラットな特性を得 た。さらに高い受光効率を得るために、アバランシェフォ トダイオード構造の導入を検討している。図7(b)には周 波数応答特性を示す。逆バイアス1V時の遮断周波数は 7.9GHzであり、TWDM-PONに適用できる十分な応答速 度を得た。



図6 ゲルマニウム受光器の断面構造



58

まとめ

IoTを支える5Gモバイルネットワーク向けの超小型光ト ランシーバー開発について紹介した。シリコンフォトニク ス技術をベースとした波長合分波フィルタの低損失化、 ゲルマニウム受光器の効率改善が進み、超小型に集積し た光送受信チップは、光トランシーバーに低消費電力と 低コストのブレークスルーをもたらすことが期待できる。

謝辞

本研究の一部はNEDOの「超低消費電力型光エレクト ロニクス実装システム技術開発」により委託を受けたも のである。 ◆◆

■参考文献

1) SFF-8431 Specifications for Enhanced Small Form Factor Pluggable Module SFP+

http://www.sfplustransceiver.com/pdf/MSA-SFF-8431.pdf

2) 太縄、他:シリコン細線光導波路機能素子の偏波無依存化、 OKIテクニカルレビュー第219号、pp. 32 – 37、2012年4月

3) H. Okayama, et al.: Polarisation rotation Bragg grating with high diffraction efficiency using Si waveguide top surface groove grating, Electronics Letters, Vol. 51, p. 1909 – 1911(2015).

4) H. Okayama, et al.: Low loss 100 GHz spacing Si arrayed-waveguide grating using minimal terrace at slab-array interface, Electronics Letters, Vol. 52, p. 1545 – 1546 (2016).

5) 小野、他:GE-PON向け導波路型Ge-PIN-PD、電子情報通 信学会2015年総合大会、C-3-56

●筆者紹介

八重樫浩樹: Hiroki Yaegashi. 情報・技術本部 研究開発 センター ネットワーク・端末技術研究開発部

【基本用語解説】

シリコンフォトニクス

シリコンを材料とする光素子技術の総称。従来の光素 子は、ヒ化ガリウム、リン化インジウムなどの化合物半 導体、あるいは石英などの誘電体を材料とすることが一 般的であった。シリコンを材料とすることにより、光素 子の小型化、光素子とシリコンLSIの集積化、生産性の 向上などが期待される。

シリコン細線光導波路

光導波路とは所望の経路に光を伝搬させるための光の 通り道である。シリコン細線光導波路はコアがシリコン、 クラッドが石英からなり、従来から用いられる石英光導 波路と比べて、光を強く閉じ込めることができ、光の経 路を鋭く曲げても光が漏れにくいので、光回路のレイア ウト面積を小さくすることができる。

偏波

光は電磁界であり、電磁界の振動方向が互いに直交す る2つの偏波成分に分けて考えることができる。本稿で は、素子基板面に対して電界の振動方向が平行な成分を TE偏波、垂直な成分をTM偏波と呼ぶ。

偏波ダイバーシティー

ー般に、偏波状態により光が媒体から感じる屈折率が 異なるので、光素子の特性は偏波状態に依存する。光受 信では、光を互いに直交する偏波成分に分離して、それ ぞれに最適化した受光器で受けた信号を足し合わせるこ とで、全体として偏波依存性を解消することができる。 これを偏波ダイバーシティーという。

59